

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

# 芯联集成电路制造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	线上参与芯联集成（688469）2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年04月23日 15:00-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 赵奇 独立董事 陈琳 财务负责人 王韦 董事会秘书 张毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司业绩情况及市值管理制度执行情况介绍</b></p> <p>2025年全球半导体行业在技术迭代、需求提升、场景渗透的多重驱动下，呈现出多领域协同发展、新兴应用场景不断拓展的总体发展趋势。与此同时，国内半导体行业技术水平不断提升，国产替代化进程快速推进，市场份额逐步提高。公司持续聚焦扩大一站式系统代工模式优势，紧抓国产替代窗口期，持续推出国内稀缺的工艺技术平台，提升公司核心竞争力。</p> <p>报告期内，公司构建了以汽车、AI（人工智能）、工控、消费为核心的四大增长引擎，报告期内公司营业收入实现81.80亿元，增速达到25.67%。主营产品收入中，车载领域业务贡献45.43%收入，持续成为公司收入增长的核心支柱；高端消费业务收入占比28.09%、工控业务收入占比18.46%，保持稳健基本盘；AI（人工智能）领域收入快速增长，占比提升至8.02%。</p> <p>得益于公司研发创新带来产品的不断迭代升级、精细化运营带来的生产效率提升以及收入增长带来的规模效益显现并带动产品竞争力的提升，2025年公</p>

司毛利润4.51亿元，同比增加3.84亿元；毛利率5.51%，较上年提高4.48个百分点。同时公司通过并购重组实现经营与管理的深度协同，推动集团化管理效率的提升，2025年公司期间费用率6.13%，较上年7.23%下降1.10个百分点；研发投入19.43亿元，研发投入占营业收入的比例23.76%。报告期内，公司在保持规模与上年基本持平的高强度研发投入的基础上，持续增强公司的盈利能力与核心竞争力。

公司高度重视市值管理工作，制定了《芯联集成电路制造股份有限公司市值管理制度》。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规于2025年12月对《市值管理制度》进行了相关修订。2025年度，公司完成了对控股子公司少数股权的收购，实现了对子公司芯联越州的全资控股，以集中优势资源重点支持SiC MOSFET等更高技术产品的研发和业务的发展，进一步强化公司核心竞争力；完成三期项目战略融资，彰显资本市场对公司技术实力和未来前景的高度认可；成立合资公司芯港联测，提升检测业务效能；快速推进新型政策性金融工具落地，提高公司资金效率；公司主体信用等级获评AAA，完成国内首单集成电路民营企业科技创新债券发行；股权激励计划进展顺利，构筑长期人才竞争优势。

## 二、互动交流

**1. 2025年公司在新技术和新市场实现重要突破，成功推出多款新产品并获得多个重大客户定点。随着新产品的全面客户导入和规模化上量，2026年公司营收有望继续保持快速增长态势，同时为2026年实现全面、有厚度的盈利转正奠定坚实基础。1. 今年销售目标是多少？完成情况和当前应对国内行业竞争的措施？二季度能否盈利？**

答：尊敬的投资者您好，公司限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标是在2026年实现营业收入100亿元。公司将通过以下方式提升公司的竞争力：一是构筑产能与技术壁垒，构建8英寸硅基、12英寸硅基、6/8英寸碳化硅三大产线，2025年晶圆年生产量达251.27万片（同比+24.68%），产销率99.62%；二是打造一站式系统代工服务生态，提供从设计服务、晶圆制造、模组封装到可靠性测试的全链条服务；三是紧抓国产替代窗口期，持续推出国内稀缺的工艺技术平台，实现功率、MEMS、BCD、MCU等技术融合。公司2026年一季度归母净利润亏损收窄至-0.88亿元，一季度收入同比增长13.19%。随着市场需求继续回升，二季度将有望保持收入环比提升。同时，公司将持续进行成本控制，提高产品附加值和盈利能力，争取早日实现盈亏平衡，感谢您的关注。

**2. 对 2026 年的业绩能否有所展望，有厚度的盈利具体表现在那里？比如净利润的规模大概在什么范围？后续有无扩产定增的计划？谢谢！**

答:尊敬的投资者您好,2026年公司碳化硅、模拟IC以及功率模块等高附加值业务占比将逐步提升,随着公司产品结构的持续优化,且随着时间推移设备折旧压力逐步降低,为公司2026年实现盈亏平衡提供核心动力。公司视市场情况和客户需求变化进行资本开支的安排。今明两年公司将保持稳定的资本开支。未来两年公司产能将聚焦三大方向:一是8寸碳化硅;二是模拟IC和MCU相关的12寸产线;三是功率模组封装。公司在资本开支投入始终保持审慎态度。感谢您的关注。

**3. 公司在车规级芯片的市场规模及2026年规划,公司在机器人相关业务布局。**

答:尊敬的投资者,您好!2025年公司实现营业收入81.80亿元,同比增长25.67%,其中车载领域业务收入占比45.43%,为公司核心增长支柱。公司车规级产品已渗透国内90%以上的新能源车企,以碳化硅(SiC)为核心技术长板,打造一站式系统代工优势。报告期内新增与主流车企合作的系统项目25个,深度合作整车厂8家,产品从主驱功率模组(IGBT/SiC)拓展至OBC、底盘、车身、热管理等关键系统,单车配套价值量不断提升。在具身智能领域,公司可为机器人提供MEMS传感器芯片、激光雷达芯片、惯性导航单元(IMU)芯片、驱动芯片及MCU等核心硬件,并提供高度集成的系统级套片方案。目前产品已成功导入多家客户,涵盖人形机器人与非人形机器人应用。感谢您的关注

**4. 1、毛利率修复情况。2025年毛利率仅约5.56%,请问2026年Q1毛利率改善情况。2、产能利用率问题。晶圆厂高折旧压力下,各产线产能利用率是否匹配订单增长,有无价格战风险。3、现金流安全垫:尽管亏损收窄,但经营性现金流是否同步改善,后续资本开支计划是否会影响资金链,尤其是2026Q1。4、2026Q2各产线订单情况。5、2026设备折旧情况如何?谢谢!**

答:尊敬的投资者您好,2026年第一季度收入19.62亿元,同比增长13.19%,毛利率进一步提升到5.69%,2026年一季度亏损0.88亿元,同比减亏51.53%。折旧与现金流方面:2025年折旧摊销合计约39亿元,占营业收入比重收窄至48%,已进入下行通道。2025年经营性净现金流21.35亿元,同比增长12%。目前订单饱满,随着市场需求继续回升,2026年以后的几个季度将有望保持收入环比实现明显提升。感谢您的关注。

**5. 公司对于资本开支、毛利率提升、设备折旧以及市值管理有可供量化的考核计划?**

答:尊敬的投资者您好,在资本开支方面,公司视市场情况和客户需求变化进行资本开支的安排,今明两年公司将保持稳定的资本开支。公司将通过销售扩大带来的规模效应、持续进行的成本控制,持续提高产品盈利能力,争取实现2026年盈亏平衡。在设备折旧方面,公司已完成初步的产线建设,折旧压力

随着时间推移逐步缓解。公司高度重视市值管理工作，制定了《芯联集成电路制造股份有限公司市值管理制度》。同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规于2025年12月对《市值管理制度》进行了相关修订。感谢您的关注。

**6. 年报提示行业周期、技术迭代、竞争加剧、客户集中等风险。请问：当前最核心的经营风险（如行业需求波动、海外技术壁垒、价格战）是什么？2026 年的风险应对与护城河构建（技术、客户、成本）具体措施有哪些？**

答:尊敬的投资者您好，在新能源和智能化的不断推动下，我国半导体产业获得了快速的发展，其中技术的迭代和服务的创新成为差异化竞争的核心动力。在战略路径上，公司通过深耕MEMS传感器和功率器件，包括Si、SiC、GaN等全系列器件及模组，全力发展模拟IC、布局车规级MCU，并融合这些技术，成为系统代工方案的提供者，与客户深度结合及绑定，以客户需求与产品创新为公司的“护城河”，提升客户综合价值与合作黏性，形成差异化竞争优势；在技术创新方面，公司前瞻性布局下一代产品技术平台，已实现功率系统与传感信号链系统相关芯片及模组技术领先，成为国内稀缺的同时具备功率、MEMS、BCD、MCU相关产能和技术的系统级代工厂；在市场拓展方面，公司通过设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工服务，构建了以汽车、AI（人工智能）、工控、消费为核心的四大收入增长引擎，抢占产业链价值高地，赋能上下游产业生态；在人才建设上，公司股权激励计划将核心员工的个人利益与公司长期价值深度绑定，构建稳固的利益共同体，持续为公司及股东创造价值。感谢您的关注。

**7. 公司在今年，转亏为盈吗？今年盈利能多少？**

答:尊敬的投资者您好，通过销售扩大带来的规模效应、持续进行的成本控制，持续提高产品盈利能力，争取实现2026年盈亏平衡，感谢您的关注。

**8. 1、公司碳化硅八吋线进展（量产爬坡及良率情况） 2、现在6吋线车规产品片间良率与国外厂商对比情况，碳化硅6吋线能否盈亏平衡**

答:尊敬的投资者您好，公司在SiC MOSFET出货量上稳居亚洲前列，是国内产业中率先突破主驱用SiC MOSFET产品的头部企业，2025年公司8英寸碳化硅已经实现量产出货。根据Yole发布的2025年碳化硅（SiC）业务排名，公司是中国SiC器件厂商中位居第一的企业，全球排名前五。感谢您的关注。

**9. 1、在晶圆代工行业的地位； 2、迟迟未盈利的原因； 3、产能和销售的关系？**

答:尊敬的投资者您好，公司是中国最大的车规级IGBT生产基地之一，SiC MOSFET出货量稳居亚洲前列，是国内率先突破主驱用SiC MOSFET产品的头部企业；在模拟IC领域，公司是国内BCD工艺布局最完整的企业之一，BCD工艺技术

达国际领先水平；在MEMS领域，公司是国内规模最大、技术最先进的MEMS晶圆代工厂，是全球最大的MEMS麦克风芯片代工厂。据Chip Insights数据，公司已迈入晶圆代工“第一梯队”，跻身全球专属晶圆代工榜单前十，中国大陆第四。公司目前仍处于产能建设期和爬坡期，前期固定资产投入大，折旧摊销费用较高；同时公司保持高强度研发投入（2025年研发投入19.43亿元，占营收23.76%），持续推出国内稀缺的工艺技术平台。随着产能利用率提升和规模效应显现，公司盈利能力持续改善，2025年毛利率5.51%（同比提升4.48个百分点），归母净利润-5.95亿元（同比减亏38.17%），2026年一季度毛利率进一步提升至5.69%。感谢您的关注。

**10. 请问赵奇董事长，公司一直强调今年经营业绩会出现有厚度的由负转正。但目前投资者最担心的就是5月14.4亿、11月11.5亿的4家巨额解禁。请问公司有没有具体的举措来让这几家投资者增强信心，不在解禁以后出现“跑得快”式减持？这成了这几个月股票跌跌不休、断崖式下跌的原因。望董事长重视，并正面回答。**

答：尊敬的投资者您好，公司有明晰的发展战略，同时将专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升。公司将积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资；同时严格按照相关法律法规进行信息披露。感谢您的关注与支持！

**11. 2026年一季度赢利多少，2026年中报能否大幅赢利并有分红打算？**

答：尊敬的投资者您好，公司2026年第一季度归母净利润-8836万元，同比减亏51.53%。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者。感谢您的关注。

**12. 认真看了公司年报，有一个非常令人意外，令人不满的指标：息税折旧摊销前利润率（%）。25年为26.62%，而24年为：32.96%。减少6.34个百分点。感觉这个是个很不应该发生，很不妙的信号。请公司领导解释解释什么原因？**

答：尊敬的投资者您好，公司2025年毛利率同比增长4.5个百分点、净利率同比减亏10.9个百分点，对应同比毛利额增加3.8亿、净利润增加3.1亿。息税折旧摊销前利润率由收基于收入的扩大使息税折旧摊销前利润率下降。2026年公司会持续进行降本增效先进措施提升管理效益，提升整理盈利水平。感谢您的关注。

**13. 尊敬的赵总，您好！ 1、2026年实现有厚度的盈利，请问这个预测有无改变。 2、根据2025年报，在2025年，芯联母公司盈利10亿，芯联越州盈利4.7亿，芯联先锋亏损11.8亿，吉光半导体亏损6亿，请问，芯联母公司和芯联越州能否保持目前盈利并逐年继续提高盈利，芯联先锋和吉光半导体分别预计哪一**

年可以扭亏为盈。多谢赵总！

答:尊敬的投资者您好, 2026年第一季度收入19.62亿元, 同比增长13.19%, 毛利率进一步提升到5.69%, 2026年一季度亏损0.88亿元, 同比减亏51.53%。随着市场需求继续提升, 公司有信心在2026年实现盈亏平衡。感谢您的关注。

**14. 赵奇总经理, 二个问题, 一是你说的有厚度的盈利是什么厚度? 是每股盈利数额大还是公司以后盈利潜力大还是二者兼之。二是公司技术储备主要在哪几个方面。公司人才现在跳槽对公司技术和商业秘密有没有泄露风险, 如何防范。**

答:尊敬的投资者您好, 公司在2026年第一季度收入19.62亿元, 同比增长13.19%, 毛利率进一步提升到5.69%, 2026年一季度亏损0.88亿元, 同比减亏51.53%。公司目前订单饱满, 随着市场需求继续回升, 我们有信心在2026年实现盈亏平衡。公司确立了功率、MEMS、BCD、MCU四大主要技术方向, 在新能源汽车、风光储、电网和数据中心等工控领域、高端消费领域所需要的产品上, 持续研发先进的工艺及技术。截至2025年12月31止, 公司累计取得专利技术574项, 其中在SiC方面, 公司8英寸SiC晶圆线量产, 性能达到国际同类厂商水平, 可提供高质量高性能的量产平台。BCD工艺技术多项处理国际领先和国内领先水平。更多技术信息可以参考公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的2025年年度报告。感谢您的关注。

**15. 请问赵总: 2026/1季业绩报告没有扭亏为盈, 不及大家预期, 半年报业绩会增长多少, 值得我们投资者期待, 谢谢🙏🙏🙏**

答:尊敬的投资者您好, 2026年一季度毛利率进一步提升, 归母净利润亏损收窄至-0.88亿元, 同比减亏51.53%。公司一季度收入同比增长13.19%。随着市场需求继续回升, 二季度将有望保持收入环比实现持续提升。感谢您的关注。

**16. 现在公司是否具备生产896线激光雷达的技术。**

答:尊敬的投资者您好, 公司具备激光雷达所需VCSEL激光器与MEMS微振镜等核心芯片的制造能力, 其发射端的光源VCSEL芯片已实现大规模量产, 信号链的平台也已准备就绪, 整体技术能力可支持生产面向前沿应用的高性能激光雷达产品。感谢您的关注。

**17. 没有视频吗**

答:尊敬的投资者您好, 本次业绩说明会以文字交流形式进行, 感谢您的关注。

**18. 关于折旧与产能利用率、毛利率之间的关系, 能否算一个清晰直观的成本账? 谢谢!**

答:尊敬的投资者您好, 折旧是固定成本的分摊, 产能利用率越高, 单位产品分摊的折旧越少, 单位折旧越低, 毛利率则越高。未来两年公司产能将聚焦

三大方向：一是8寸碳化硅；二是模拟IC和MCU相关的12寸产线；三是功率模组封装。公司在资本开支投入始终保持审慎态度，不希望进一步增加折旧压力。同时公司将通过销售扩大带来的规模效应、持续进行的成本控制，持续提高产品盈利能力。感谢您的关注。

**19. 二季度能否实现有厚度的盈利？**

答：尊敬的投资者您好，公司一季度实现营业收入19.62亿元（同比+13.19%），归母净利润-0.88亿元（同比减亏51.53%），扣非净利润-1.52亿元（同比减亏34.15%）。公司一季度保持了较高的产能利用率并持续改善整体盈利能力，有望在2026年内达成全年扭亏为盈的目标。感谢您的关注。

**20. 请问贵公司对机器人行业的看法和介绍一下贵公司在这个行业的布局**

答：尊敬的投资者您好，在人工智能领域，公司深度参与产业链的业务布局。公司可为具身智能提供核心MEMS传感器芯片、激光雷达芯片、惯性导航单元（IMU）芯片、驱动芯片以及MCU等关键硬件，并提供高度集成的系统级套片方案。目前产品已成功导入多家客户，涵盖了人形机器人与各类非人形机器人应用。公司将持续紧跟行业发展趋势，不断创新，并持续扩大为机器人新系统提供电源、电驱、传感等各类芯片的能力。感谢您的关注。

**21. 各位领导好。关注到，虽然芯联集成近两年净利连续减亏，2026年一季度也同比减亏，但非经损益也是在逐年上升的，2025年金融资产收益更是高达1.68亿元，远高于24年、23年的3315.30万元、5776.72万元，是否意味着公司扭亏为盈仍然依赖非经损益？**

答：尊敬的投资者您好。为夯实供应链保障能力、稳定产品供给与市场渠道，公司对产业链上下游开展战略性投资，强化产业链资源整合与协同联动，构建稳定高效的供应链体系与业务生态。随着市场需求继续回升，公司也通过持续进行成本控制，提高产品附加值和盈利能力，争取早日实现盈亏平衡，感谢您的关注。

**22. 请问公司子公司吉光半导体亏损达到6亿多，有什么扭亏计划？**

答：尊敬的投资者您好，吉光主要负责集团战略定位模组相关的业务。目前在模组封装方面，公司的功率模块出货量位居中国市场前列。根据NE时代统计，2025年公司在国内乘用车功率模块装机量排行榜位列第四，SiC MOSFET芯片及模组已全面覆盖650-3300V碳化硅工艺平台，产品关键指标均处于国内领先水平。2026年，公司将持续进行成本控制，提高产品附加值和盈利能力，争取早日实现盈亏平衡，感谢您的关注。

**23. 公司在今年第二季度是否可以实现全面盈利？**

答：尊敬的投资者您好，公司一季度实现营业收入19.62亿元（同比+13.19%），归母净利润-0.88亿元（同比减亏51.53%），扣非净利润-1.52亿元

(同比减亏34.15%)。公司将努力争取在2026年实现整体盈利的目标。

**24. 价格有涨价吗？目前订单如何**

答:尊敬的投资者您好，公司在今年一季度已经根据市场情况对MOSFET产品进行了价格调整。从市场需求来看，IGBT产品从去年四季度至今年一季度价格走稳，同时近期市场需求旺盛，可能会出现需求大于供给的情况。公司将密切关注市场和客户需求的变化，感谢您的关注。

**25. 想请教财务总很多财务数据上的问题：①公司此前研发投入全额费用化，2025年首次出现1.05亿元研发资本化，此举是否为调节利润、美化报表？资本化的研发项目具体进展与盈利前景如何？②2025年末货币资金较期初大降42.94%，减少超22亿元，资金快速消耗的核心原因是什么？当前资金储备能否覆盖偿债、扩产、运营需求，是否存在资金链紧张风险？③应收账款同比激增62.97%，增速远超营收，下游回款明显拉长，是否存在回款困难、坏账计提不足的情况？坏账风险管控措施是否有效？**

答:尊敬的投资者您好，公司目前已有两个新的工艺平台研发项目进入开发阶段，考虑到公司有足够的技术和财务资源满足项目开发工作且未来能够产生较大的经济利益流入。因此根据会计准则进行核算。2025年末货币资金的减少主要因为公司做了结构性存款和大额存单等现金管理，提高公司的货币资金利用率，也提升了闲置资金的存款收益。应收账款的变化主要是客户结构的变化引起的，但帐期都在一年以内，公司严格根据会计政策和内控制度管理，不存在回款困难、坏账计提不足的情况。感谢您的关注。

**26. 可以看到贵公司在2025年资产减值方面相比2024和2023有很大的改善，请问主要原因？后面2026和2027年会继续改善吗？**

答:尊敬的投资者您好，关于资产减值下降的原因，一是公司前期已按照审慎原则对相关资产足额计提，二是公司持续聚焦主业经营，加强供应链管理、库存管控及应收账款回收，随着毛利率的提升，整体经营质量和资产运营效率稳步提升，减值准备的计提也会随之减少。未来公司将继续坚持稳健经营，持续优化产品结构，提升经营质量，努力保持资产质量稳健，力争减值水平维持在合理可控区间。感谢您的关注。

**27. 即将面临大规模解禁，当前股价与公司宣称的的良好市场环境和发  
展势头形成强烈反差，公司有什么预案？发起人股东有无减持计划？**

答:尊敬的投资者您好，公司发展战略清晰，同时专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升。公司将积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资；同时严格按照相关法律法规进行信息披露。感谢您的关注与支持！

**28. 25年芯联越州实现盈利，吉光、芯联先锋、芯联动力亏损，是折旧压**

力还是产品良率以及产品问题造成的；26年一季度芯联越州盈利了吗，吉光、芯联先锋、芯联动力依旧亏损吗？

答：尊敬的投资者您好，公司部分子公司尚处于产线建设初步完成、市场拓展快速增长阶段，产品结构尚未完全优化，规模效益未完全体现，2026年公司通过营收快速增长带来的规模扩大、有效控制成本等措施争取早日实现公司盈亏平衡，感谢您的关注。

**29. 一季度营收中海外占比多大，同比增长情况如何，未来将呈现何种趋势**

答：尊敬的投资者您好，公司2025年外销收入5.88亿元，同比增长11.65%。2026年公司将积极拓展公司在汽车、AI（人工智能）、高端消费、工业控制四大应用领域的市场需求，提高市占率。感谢您的关注。

**30. 公司各个产线的良率是多少，良率达到多少是盈亏平衡线**

答：尊敬的投资者您好，公司各产线的良率始终保持在较高水平。盈亏平衡受多因素影响，随着收入规模增长和折旧压力的稳步下降，公司毛利率稳步提升，净利润也会取得明显突破，从而争取2026年实现全面、有厚度的盈利转正。感谢您的关注。

**31. 1、公司的营收指引依旧是：营收100亿，26年做到有厚度的盈利吗？  
2、公司一季度营收只有19亿多，公司有信心完成100亿营收吗？一季度涨价后，是需要在二季度再能显现吗？**

答：尊敬的投资者您好，2025年公司营业收入达81.8亿元，同比增长25.67%。公司限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标是2026年营业收入实现100亿，公司对于完成股权激励目标充满信心。感谢您的关注。

**32. 请问：8/12 英寸硅基、6/8 英寸 SiC 产线的当前产能利用率、2026年扩产计划与资本开支预算如何？在持续大额资本开支下，如何保障现金流安全并支撑扭亏？**

答：尊敬的投资者您好，公司始终产能利用率始终保持较高水平，今明两年公司将保持稳定的资本开支。未来两年公司产能将聚焦三大方向：一是8寸碳化硅；二是模拟IC和MCU相关的12寸产线；三是功率模组封装。公司已从“规模扩张”向“技术深耕”转变，折旧占营业收入的比重将逐步下降，有望在2026年实现全年盈利。感谢您的关注。

**33. 想请问各位领导，公司年报称 2026 年冲刺盈利转正，但从目前的数据来看，2025 年公司销售费用同比大增69.92%，远超营收 25.67% 的增速，是否意味着客户和订单拓展效率不够？公司营收增长是否完全靠“砸钱”，内生增长动力何在？**

答：尊敬的投资者您好，2025年公司构建了以汽车、AI（人工智能）、工控、消费为核心的四大增长引擎；在市场拓展方面，公司通过设计服务、晶圆

制造、模组封装、应用验证到可靠性测试的一站式系统代工服务，抢占产业链价值高地，赋能上下游产业生态。销售费用的增加主要为公司处于市场拓展快速增长阶段，为持续拓展市场与客户，市场拓展及人员费用等增加。销售费用相关的投入为公司未来的快速增长和持续领先铺平了道路。感谢您的关注。

**34. 没有视频吗？**

答：尊敬的投资者您好，本次业绩说明会以文字交流形式进行，感谢您的关注。

**35. 请问公司在哪些产品上实现提价，提价比例是多少？**

答：尊敬的投资者您好，公司在今年一季度已经根据市场情况对MOSFET产品进行了价格调整。从市场需求来看，IGBT产品近期市场需求旺盛势，可能会出现需求大于供给的情况。公司将密切关注市场和客户需求的变化，根据市场规律调整。感谢您的关注。

**36. 公司盈亏平衡点，需要毛利率达到多少？碳化硅衬底从15000讲到现在3000多，碳化硅mos拐点已到吗？igbt增量市场会不会被sic mos取代？公司怎样平衡之间的关系。另外，国内厂商都纷纷上马碳化硅产线，未来一两年碳化硅是否又要打价格战，公司怎样应对，以及公司全面盈利是否延后。**

答：尊敬的投资者您好，公司各量产产线的良率始终保持高水平，盈亏平衡受多因素影响，随着收入规模增长和折旧压力的稳步下降，公司毛利率稳步提升，净利润也会取得明显突破。随着SiC器件性价比的提高，SiC MOSFET的应用从原来高度集中于车的主驱逆变，扩展到车载充电、热管理、主动悬架；同时也开始向非车载应用的空调、服务器电源、储能等多个领域扩展。公司作为全球领先的SiC制造厂商，在巩固和提升车的主驱逆变方面的市场份额外，已经准备好向这些新应用领域提供先进的、有竞争力的产品。在功率器件领域，公司的SiC MOSFET出货量稳居亚洲前列，是国内产业中率先突破主驱用SiC MOSFET产品的头部企业，2025年公司8英寸碳化硅已经实现量产出货；在模组封装方面，目前公司SiC MOSFET芯片及模组已全面覆盖650-3300V碳化硅工艺平台，产品关键指标均处于领先水平。感谢您的关注。

**37. 公司有没有算电协同及光通信芯片业务**

答：尊敬的投资者您好。公司已构建覆盖AI服务器电源从一次电源、二次电源到三次电源的一站式系统代工解决方案，提供功率器件、驱动IC、磁器件、MCU等产品；同时，公司已提前布局MicroLED光通信，应用于新一代车灯光源、数据中心光通信及微显示等前沿领域，推动相关技术从实验室加速向产业化转化，为未来数据中心提供更高效、更可靠的传输方案。谢谢您的关注。

**38. 请问贵司2026年折旧费预计多少亿？**

答：尊敬的投资者您好，公司已从“规模扩张”向“技术深耕”转变，折旧

占营业收入的比重将逐步下降。感谢您的关注。

**39. 请问贵司2026年有收购其他公司提高产能的计划吗？**

答:尊敬的投资者您好,公司将视市场情况和客户需求变化进行资本开支的安排。公司产能将聚焦三大方向:一是8寸碳化硅;二是模拟IC和MCU相关的12寸产线;三是功率模组封装。若出现重大收购事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

**40. 请问, 2026年能否实现营收到达100亿。谢谢您!**

答:尊敬的投资者您好,2025年公司营业收入达81.8亿元,同比增长25.67%。公司限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标是2026年营业收入实现100亿元。公司将努力实现该目标。感谢您的关注。

**41. 请问公司90多亿的有息贷款还款计划, 每年需要支付多少利息, 支付利息的资金来源**

答:尊敬的投资者您好,公司2025年新型政策性金融工具的落地、集成电路企业科技创新债券的发行,开拓了多元化融资渠道,优化公司资本成本与融资结构,公司2025年度利息费用较上年同期明显减少。2026年公司将进一步拓展融资渠道,降低融资成本,提升公司整体的盈利能力,感谢您的关注。

**42. 请问贵司2025年度模组封装是否亏损? 亏损原因是什么? 有何改善改进措施?**

答:尊敬的投资者您好,2025年公司模组封装收入15.08亿元,同比增长150.62%,毛利率比上年提升1.75个百分点。模组封装业务将推动公司与客户的合作深度、广度和黏性,带动公司未来收入的快速增长。感谢您的关注。

**43. 请问贵司高管是否持有公司股份? 分别是多少?**

答:尊敬的投资者您好,公司高管未直接持有公司股份,仅通过持有公司员工持股平台的份额间接持有。感谢您的关注。

**44. 请问公司产品外销占比有多少? 是否有竞争力? 预计2026年会拓展外销渠道吗?**

答:尊敬的投资者您好,公司2025年外销收入5.88亿元,同比增长11.65%;毛利率同比提升15.02个百分点。2026年公司将积极拓展公司在汽车、AI(人工智能)、高端消费、工业控制四大应用领域的市场需求,提高市占率。感谢您的关注。

**45. 5月11日解禁的股票是否会出售**

答:尊敬的投资者您好,公司将积极做好与股东的沟通,引导股东长期投资;同时严格按照相关法律法规进行信息披露。感谢您的关注与支持!

**46. 出售资产的收益什么时候能确认**

答:尊敬的投资者您好,2025年12月9日公司披露《关于拟对外出售资产暨

	<p>关联交易的进展公告》，公司控股子公司芯联先锋与临港新片区基金设立合资公司上海芯港联测半导体有限责任公司相关事项已完成。感谢您的关注。</p> <p><b>47. 请问贵司2026年全年产能将会处于饱和状态吗？还会进一步扩产吗？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，2025年公司初步完成了前期产能建设，构建了8英寸硅基、12英寸硅基产线、6/8英寸碳化硅三大产线，晶圆年生产量251.27万片（折合8英寸），同比增长24.68%。同时12英寸硅基产线将重点覆盖BCD、MCU等高端混合信号与控制类产品。公司视市场情况和客户需求变化进行资本开支的安排。未来两年公司产能将聚焦三大方向：一是8英寸碳化硅；二是模拟IC和MCU相关的12寸产线；三是功率模组封装。感谢您的关注。</p> <p><b>48. 请问贵司2026年一季度库存品是已有订单的库存还是等待销售的库存？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司存货主要为原材料、在产品。2025年公司产销率为99.62%，同比提升3.04个百分点；库存量比上年同期减少19.50%。感谢您的关注。</p> <p><b>49. 请问公司的晶圆加工是否会提价？提价百分比多少？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好，公司在今年一季度已经根据市场情况对MOSFET产品进行了价格调整。从市场需求来看，IGBT产品从去年四季度至今年一季度价格走稳，同时近期市场需求有较高的增长趋势，可能会出现需求大于供给的情况。公司将密切关注市场和客户需求的变化，根据市场规律调整。感谢您的关注。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年04月23日</p>